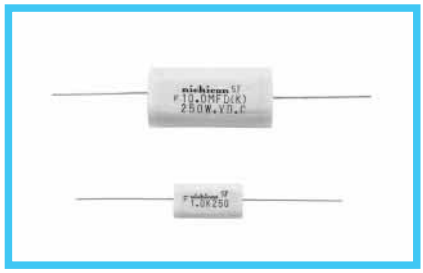
AP

金属化聚丙烯薄膜电容器

（编带式高频用标准品）系列

高频对应品

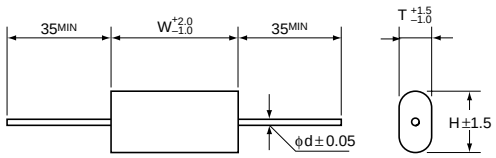
- 编带封装结构的小形大容量电容器，使用了对感应体具有优良高频特性的金属化聚丙烯薄膜，适合用于高频电路及充放电电路。
- 具有优良的机械强度＆耐热特性
- 用于交流的路中时，根据电路条件的不同，有时会发生故障、出现发热、放电等现象。详情请咨询我们。
- RoHS指令(2002/95/EC)已对应完毕



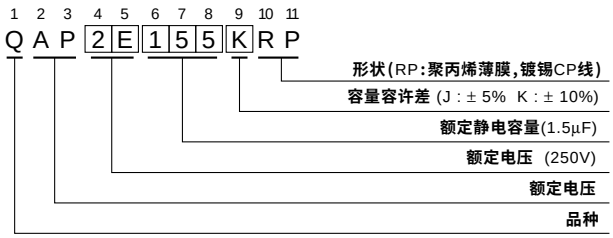
■ 仕样

项目	性　　能
分类温度范围	–40 ~ +85℃
额定电压范围	250, 400, 630V.D.C.
额定静电容量范围	0.15 ~ 10μF
额定静电容量容许差	±5% (J), ±10% (K)
介质损耗正切	0.1%以下 (1kHz 20℃)
绝缘电阻	C≤0.33μF：30000MΩ以上　C > 0.33μF：10000ΩF以上
耐电压	端子与端子之间 ：额定电压 × 175%, 1 ~ 5 秒. 端子与封装之间 ：额定电压 × 200%, 1 ~ 5 秒.
封装	粘合性聚酯薄膜　环氧树脂

■ 尺寸图



品号编码体系（例：250V 1.5μF）



■ 尺寸表

单位: mm

(μF) 额定静电容量	V(编码) / 尺寸 / 品号编码	250VDC (2E)				400VDC (2G)				630VDC (2J)			
		T	W	H	d	T	W	H	d	T	W	H	d
0.15	154									4.8	28.0	11.4	0.8
0.22	224									5.6	28.0	13.8	0.8
0.33	334					6.1	28.0	12.7	0.8	7.4	28.0	15.6	0.8
0.47	474	4.3	28.0	10.9	0.8	7.7	28.0	14.2	0.8	7.8	33.0	15.9	0.8
0.68	684	5.0	28.0	13.2	0.8	9.0	28.0	17.2	0.8	9.9	33.0	18.1	0.8
1.0	105	6.5	28.0	14.7	0.8	9.7	33.0	17.9	0.8	10.4	38.0	20.1	1.0
1.5	155	8.6	28.0	16.7	0.8	11.9	33.0	21.6	0.8	12.0	44.0	21.7	1.0
2.2	225	9.3	33.0	17.5	0.8	13.3	38.0	22.7	1.0	15.3	44.0	25.0	1.0
3.3	335	11.4	33.0	21.1	0.8	15.4	44.0	25.1	1.0	17.9	50.0	27.6	1.0
4.7	475	12.6	38.0	22.3	1.0	17.5	50.0	27.2	1.0				
6.8	685	14.3	44.0	24.0	1.0								
10.0	106	16.6	50.0	26.3	1.0								